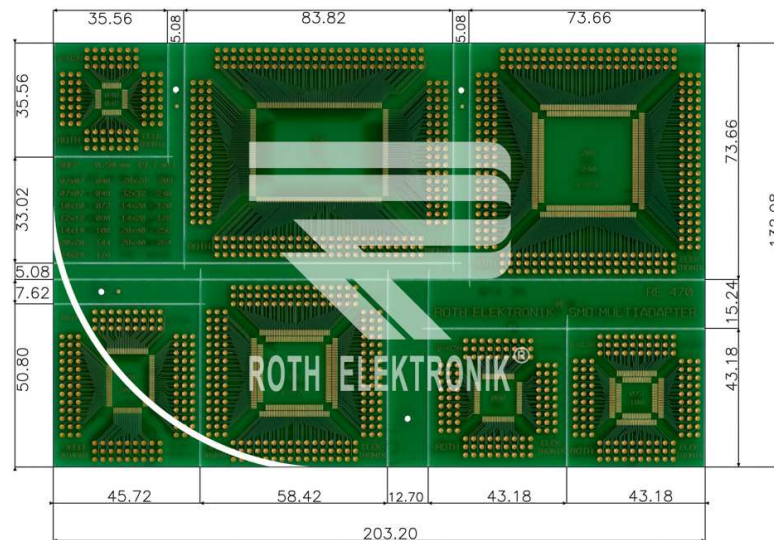


RE470

- Epoxy fibre-glass FR4 1.50 mm
 - Double-sided 35 µm Cu
 - Plated through holes (PTH)
 - Surface chem. Ni/Au with solder stop mask
 - Pitch 0.40 mm (15.7mil) and 0.50 mm (19.7 mil.)
 - Adaption board for 23 different SMD-QFP s
 - Hole diameter 1.00 mm
 - Prescratched rated break point for the separation of individual modules from the board
 - Gerber data for manufacture of the solder resist masks and the soldering paste imprint will be provided free of charge on request
 - Size 132 x 203 mm
- Module-No. Pitch Pin mil Size (mm)

RE470-01 S 0.500 mm QFP 40, 48 19.7 7.00 x 7,00 S 0.400 mm QFP 80 15.7 10,00 x 10,00 RE470-02 S 0.500 mm QFP 80 19.7 12.00 x 12.00 S 0.400 mm QFP 100, 108 15.7 12.00 x 12.00 RE470-03 R 0.500 mm QFP 120, 128 19.7 14.00 x 20.00 R 0.400 mm QFP 100, 108 15.7 10.00 x 14.00 RE470-04 S 0.500 mm QFP 72, 100 19.7 10.00 x 10.00 S 0.400 mm QFP 12 15.7 14.00 x 14.00 RE470-05 S 0.500 mm QFP 144, 176 19.7 20.00 x 20.00, 24.00 x 24.00 S 0.400 mm QFP 184 15.7 20.00 x 20.00 RE470-06 R 0.500 mm QFP 256, 264 19.7 28.00 x 40.00 R 0.400 mm QFP 224, 232 15.7 20.00 x 28.00 RE470-07 S 0.500 mm QFP 208, 240 19.7 28.00 x 28.00, 32.00 x 32.00 S 0.400 mm QFP 264 15.7 28.00 x 28.00

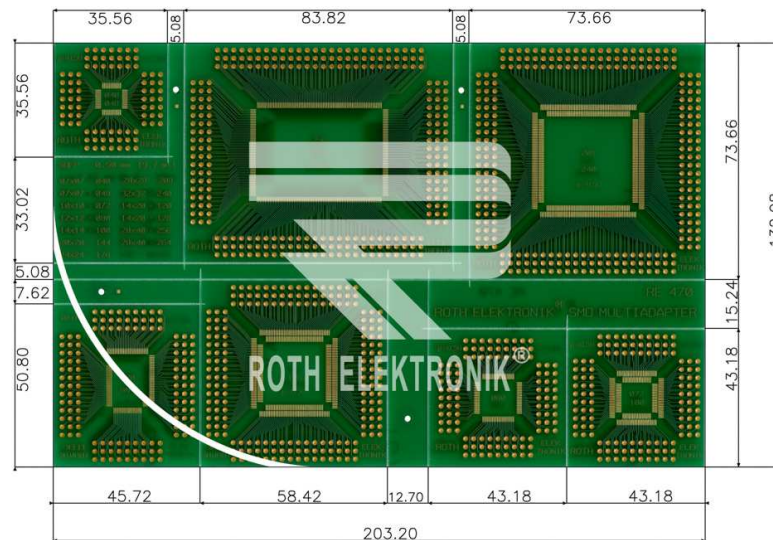


RE470

- Epoxyd FR4 1,50 mm
 - Zweiseitig 35 µm Cu
 - Durchkontaktiert (PTH)
 - Oberfläche chem. Ni/Au mit Lötstopmmaske beschichtet
 - Pitch 0,40 mm (15,7 mil) und 0,50 mm (19,7mil)
 - Adaptionsplatine für 23 verschiedene SMD-QFPs
 - Lochdurchmesser 1,00 mm
 - Vorgeritzte Sollbruchstellen zum Trennen einzelner Module von der Platine
 - Gerberdaten zur Herstellung der Lötstopmmaske und des Lötpastenaufdrucks werden auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt
 - Größe 132,00 x 203,00 mm
- Modul-Nr. Pitch Pin mil Größe (mm)

RE470-01 S 0,500 mm QFP 40, 48 19,7 7,00 x 7,00 S 0,400 mm QFP 80 15,7 10,00 x 10,00 RE470-02 S 0,500 mm QFP 80 19,7 12,00 x 12,00 S 0,400 mm QFP 100, 108 15,7 12,00 x 12,00 RE470-03 R 0,500 mm QFP 120, 128 19,7 14,00 x 20,00 R 0,400 mm QFP 100, 108 15,7 10,00 x 14,00 RE470-04 S 0,500 mm QFP 72, 100 19,7 10,00 x 10,00 S 0,400 mm QFP 12 15,7 14,00 x 14,00 RE470-05 S 0,500 mm QFP 144, 176 19,7 20,00 x 20,00, 24,00 x 24,00 S 0,400 mm QFP 184 15,7 20,00 x 20,00 RE470-06 R 0,500 mm QFP 256, 264 19,7 28,00 x 40,00 R 0,400 mm QFP 224, 232 15,7 20,00 x 28,00 RE470-07 S 0,500 mm QFP 208, 240 19,7 28,00 x 28,00, 32,00 x 32,00 S 0,400 mm QFP 264 15,7 28,00 x 28,00

ver.20150130



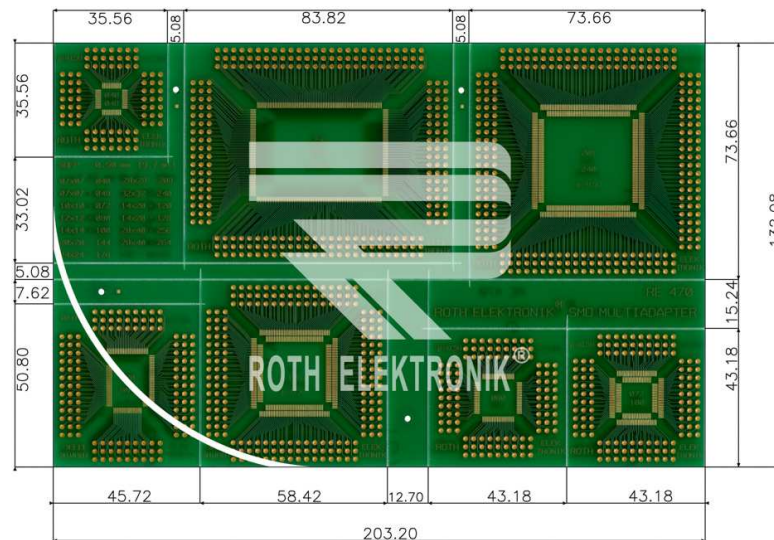
RE470

- Fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique et un masque d'arrêt de soudure
- Pitch 0,40 mm (15,7 mil) et 0,50 mm (19,7 mil)
- Platine d'adaptation pour 23 CMS-QFP différents
- Perforation 1,00 mm Ø
- Points destinés à la rupture pour séparer des modules de la platine
- Les données Data Gerber d'apprêt pour l'établissement du laque d'arrêt de soudure et de l'application de pâte à braser seront mis à disposition gratuitement
- Dimensions 132 x 203 mm

Module-No. Pitch Pin mil Dimensions (mm)

RE470-01 S 0,500 mm QFP 40, 48 19,7 7,00 x 7,00 S 0,400 mm QFP 80 15,7 10,00 x 10,00 RE470-02 S 0,500 mm QFP 80 19,7 12,00 x 12,00 S 0,400 mm QFP 100, 108 15,7 12,00 x 12,00 RE470-03 R 0,500 mm QFP 120, 128 19,7 14,00 x 20,00 R 0,400 mm QFP 100, 108 15,7 10,00 x 14,00 RE470-04 S 0,500 mm QFP 72, 100 19,7 10,00 x 10,00 S 0,400 mm QFP 12 15,7 14,00 x 14,00 RE470-05 S 0,500 mm QFP 144, 176 19,7 20,00 x 20,00, 24,00 x 24,00 S 0,400 mm QFP 184 15,7 20,00 x 20,00 RE470-06 R 0,500 mm QFP 256, 264 19,7 28,00 x 40,00 R 0,400 mm QFP 224, 232 15,7 20,00 x 28,00 RE470-07 S 0,500 mm QFP 208, 240 19,7 28,00 x 28,00, 32,00 x 32,00 S 0,400 mm QFP 264 15,7 28,00 x 28,00

ver.20150130



RE470

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
 - Por dos lados 35 µm de Cu
 - Agujeros con contactos metalizados de Ø 1,00 mm (PTH)
 - Superficie terminal química de Ni/Au y una máscara de inhibidora de la soldadura
 - Distancia entre zonas terminales 0,40 mm y 0,50 mm
 - Placa de circuito impreso de adaptación para 23 SMD-QFP diferentes
 - Diámetro de agujero 1,00 mm
 - Puntos de ruptura controlada prearrayados para separar módulos individuales de la placa de circuito impreso
 - Bajo demanda se ponen a disposición gratuitamente los datos Gerber para la fabricación de la máscara inhibidora de la soldadura y impresión de pasta d soldar
 - Tamaño 132 x 203 mm
- Módulo-No. Pitch Pin mil Tamaño (mm)

RE470-01 S 0.500 mm QFP 40, 48 19.7 7.00 x 7.00 S 0.400 mm QFP 80 15.7 10.00 x 10.00 RE470-02 S 0.500 mm QFP 80 19.7 12.00 x 12.00 S 0.400 mm QFP 100, 108 15.7 12.00 x 12.00 RE470-03 R 0.500 mm QFP 120, 128 19.7 14.00 x 20.00 R 0.400 mm QFP 100, 108 15.7 10.00 x 14.00 RE470-04 S 0.500 mm QFP 72, 100 19.7 10.00 x 10.00 S 0.400 mm QFP 12 15.7 14.00 x 14.00 RE470-05 S 0.500 mm QFP 144, 176 19.7 20.00 x 20.00, 24.00 x 24.00 S 0.400 mm QFP 184 15.7 20.00 x 20.00 RE470-06 R 0.500 mm QFP 256, 264 19.7 28.00 x 40.00 R 0.400 mm QFP 224, 232 15.7 20.00 x 28.00 RE470-07 S 0.500 mm QFP 208, 240 19.7 28.00 x 28.00, 32.00 x 32.00 S 0.400 mm QFP 264 15.7 28.00 x 28.00